

ハヤシレピック株式会社

技術分野

電気・電子・光学

技術キーワード

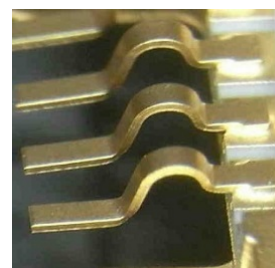
半導体組立試作・厚膜・洗浄

所在地	[本社] 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目28番3号				
資本金	5,000万円	従業員数	285名	設立年(西暦)	1965年
主要事業	照明装置、電動ドライバー、電子クーラーの製造販売、半導体組立試作、厚膜印刷				
Webサイト	https://www.h-repic.co.jp/				
連絡先(部署・氏名)	第3事業部 堀口 義和				
TEL	0470-22-8021	Eメール	horiguchi@h-repic.co.jp		
得意な技術・製品	微細実装組立技術・半導体組立実装応用製品				
得意な顧客・市場分野	通信系機器製造メーカー・微細加工組立を必要とする分野				
生産拠点・研究体制	館山工場：千葉県館山市・技術部門				
特記事項(取得資格・認証等)	ISO9001, ISO14001, ISO27001				

PR詳細

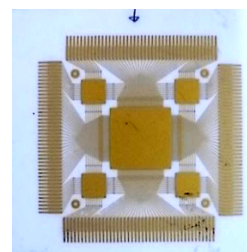
第3事業部紹介 半導体組立実装(セラミックパッケージ)厚膜製品製造、クリーン洗浄
半導体組立 試作・量産

半導体組立、セラミックパッケージへの実装配線
(アルミ太線用ワイヤーボンダー導入しました。)
精密組立検査等、顕微鏡を使用した作業が得意です。
もちろんクリーンルームでの作業です。



厚膜製品製造

スクリーン印刷技術を用い、厚膜製品を製造しています。
主に厚膜回路・電子回路用基板や放射線検出機などの部品
センサーやヒーターなどに使用されています。
特殊回路基板を製作します。(600mm角まで対応可能)
少量試作からお受け致します。



クリーン洗浄



半導体製造装置などクリーンな環境で、清浄度の求められる部品の洗浄(クリーン洗浄・精密洗浄)を行っております。
クリーンルームからクリーンルームへ2重梱包がクリーン度を保ちます。

その他事業部の紹介も行います。(照明装置、電動ドライバー、電子クーラー等)